小型包封金属化聚丙烯膜电容器

(CBB21X)规格书

特点

■电容器容量范围从 0.01uF 到 0.18uF。

■工作温度：-40℃～105℃。

■储存温度：15℃~35℃。

■损耗少，内部温升小。

■高频损耗少内部温升小。

■内部温升小。

■金属化聚丙烯膜。

■阻燃环氧粉末包封(UL94-V-0)。

用途

■广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中。

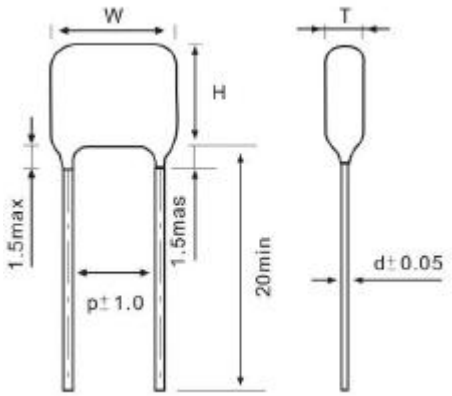
■适用于体积要求小，性能优异的彩电 S 校正。

料号与订货信息请咨询。

技术要求

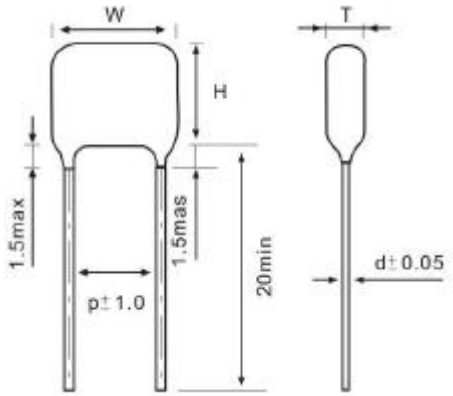
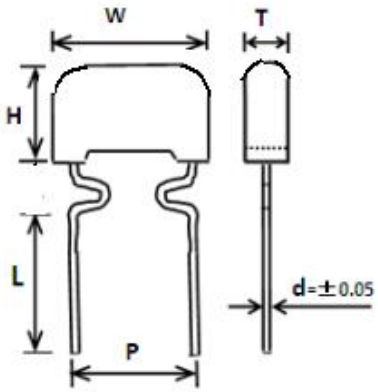
气候类别	40/100/21
额定电压	63VDC、100VDC、250VDC
损耗角正切	≤0.1%(1KHz、1.0Vrms、20℃)
耐电压	$1.6U_R$ (5s)
绝缘电阻	C≤0.33uF,IR≥50000MΩ C＞0.33uF,IR≥15000S (AT 100VDC、60SEC、20℃)

外形尺寸 (mm)



容量(uF)	电压	尺寸(mm)				
		W±0.5	H±1.0	T±1.0	P±1.0	d±0.05
0.01	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	7.5	3.5	5.0	0.5
0.012	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	7.5	4.0	5.0	0.5
0.015	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	8.0	4.5	5.0	0.5
0.018	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	8.5	5.0	5.0	0.5
0.022	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	8.5	4.5	5.0	0.5
0.033	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	8.5	5.0	5.0	0.5
0.047	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	10.5	5.0	5.0	0.5
0.056	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	9.0	4.5	5.0	0.5
0.068	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	10.0	5.0	5.0	0.5
0.082	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	10.5	5.5	5.0	0.5
0.1	63VDC/100VDC/250VDC	7.0	11.5	6.0	5.0	0.5
0.12	63VDC/100VDC	7.0	10.0	5.0	5.0	0.5
0.15	63VDC/100VDC	7.0	11.0	5.5	5.0	0.5
0.18	63VDC/100VDC	7.0	11.5	6.0	5.0	0.5

脚型、脚长说明

脚型	图示	脚长 L (mm)
长直脚脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0
内弯脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0

编带尺寸 (mm)

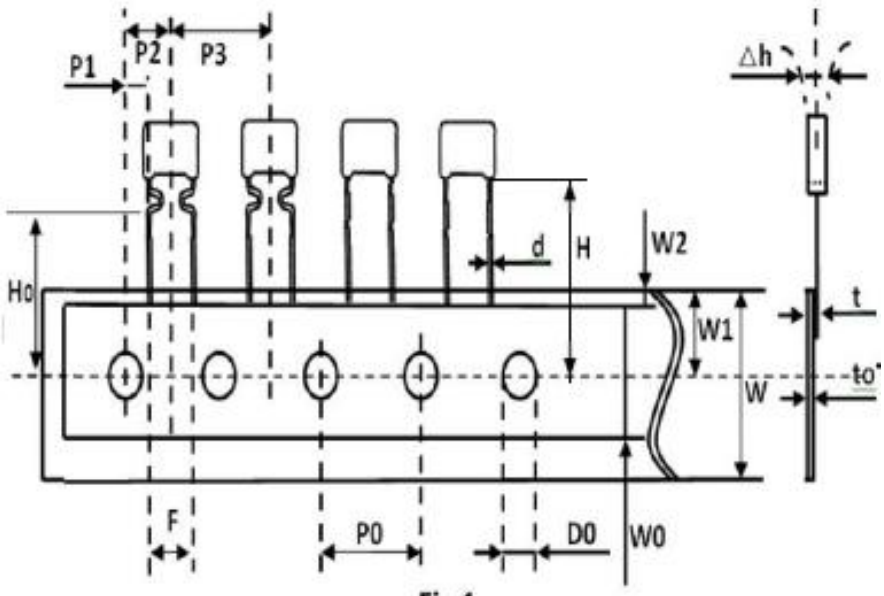
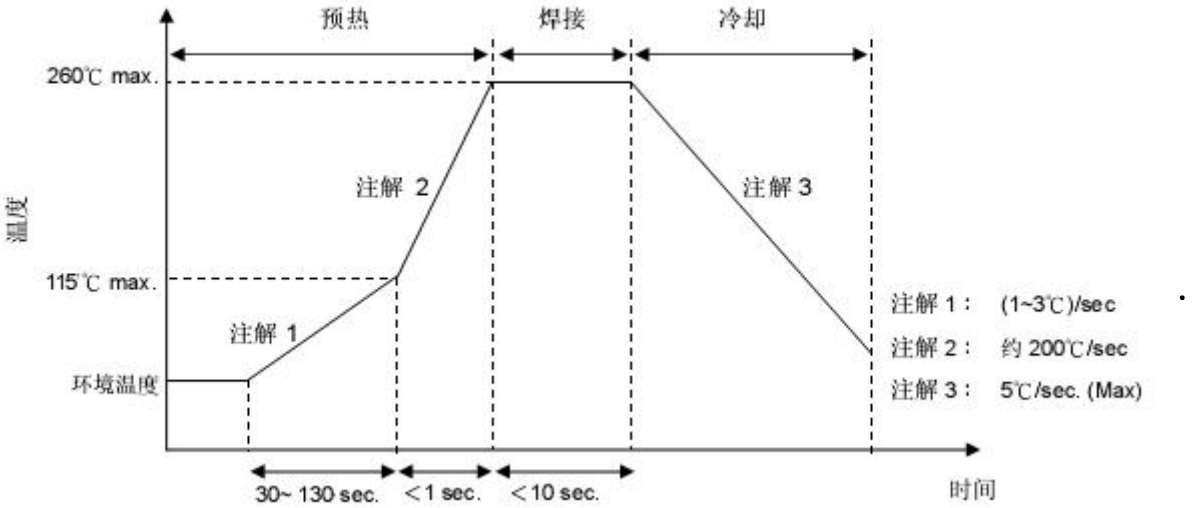


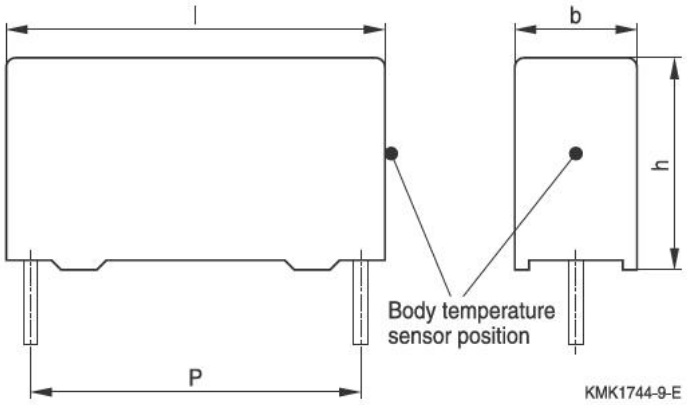
Fig.1

代码	Fig.1 P=5.0	误差
P3	12.7	±1.0
P2	6.35	±1.3
P0	12.7	±0.3
P1	3.85	±0.7
F	5.0	±1.0
H	20.0	±1.0
H0	16.5	±0.5
Δ h	0	±2.0
W	18.0	+1.0/-0.5
W0	12.0	±1.0
W1	9.0	±0.5
W2	3.0	Max
D0	4.0	±0.3
d	0.5	±0.05
t	1.0	±0.2
t0	0.38	±0.04

焊接条件：

波峰焊曲线





PP:
During pre-heating: Tp ≤110℃
During soldering: Ts ≤120℃, ts ≤15 s
PE:
During pre-heating: Tp ≤125℃
During soldering: Ts ≤160℃, ts ≤15 s

烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	350℃(max.)
焊接时间	3 sec(max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm(min.)

注：薄膜电容器不适合回流焊焊接，否则产品会因热收缩导致性能问题。